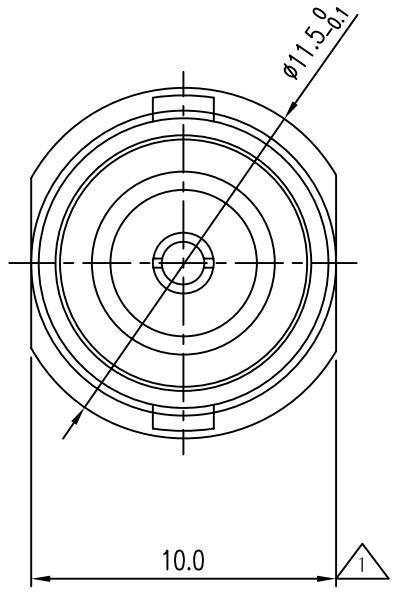
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

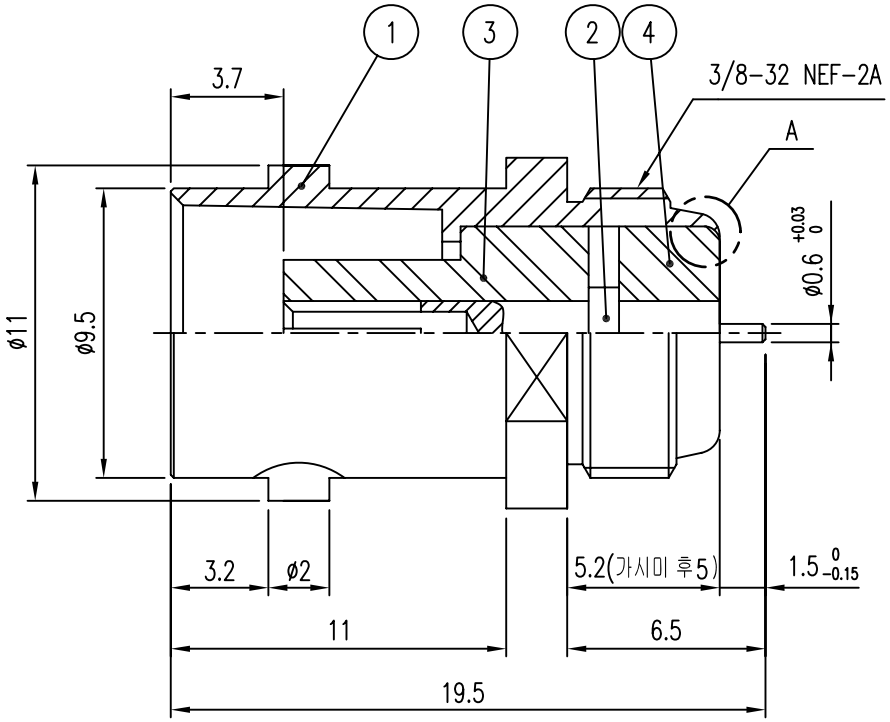
수 정 내 용

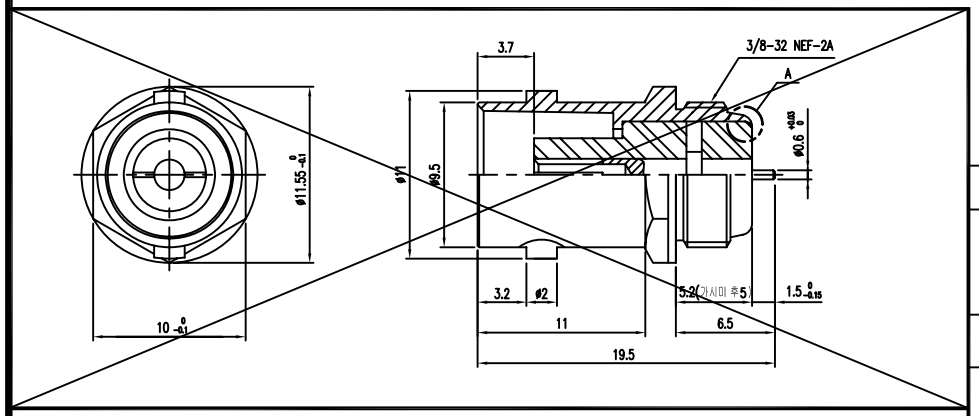
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	현품과 형상 상이함으로 인한 플랜지부 육각 → H-CUTTING 변경 / 조립공차 변경	은선영	김인철	2021. 04. 05

* 주 기

1. A부분 가시미 작업할곳.







1 Rev.1 전 형상 (SACALE 2:1)

품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
4	INSULATOR	1	TEFLON		H6149 (DIN01088-N/1)
3	INSULATOR	1	TEFLON		H6103 (DIN01087-N/1)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	E6144 (DCT01181-5/1)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	D6169 (DBD01552-5/1)

1

대체가능재질

공통공차

.* ±0.2 ~~±0.1~~ 1

.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2007. 10. 11.

승인

검도

제도

검도

작성부서 연 구 소

척도 4/1 단위 mm 중량 —

KJ COMTECH

KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 BNC50-J-BR-R

A4

도번 CN00894-7/1

K325-564-001